

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Pakkethoeveelheid	Diepte	Breedte
-----------------	------	-----------	-------------------	--------	---------

24830-001	Warmtegeleider	Gevallen	1	50 mm	50 mm
-----------	----------------	----------	---	-------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE